

朝阳回收各类电子料库存处理电子料回收

产品名称	朝阳回收各类电子料库存处理电子料回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

朝阳回收各类电子料库存处理电子料回收

C0603C154J4RAC7867 DG418DY-T WR02X561 JAL C3216X5R1E106M085AC ESD5Z5.0T1G
RK73H2ATTD6652F CL21A106KOFNNE BCM7356ZZKFEB3G GRM1555C1H1R2BA01D
RM04FTN1022 TS5A21366RSER SI4435DDY-T1-GE3 GRM21BR61C106KE15L

1999初日本上村公司曾推出一种U - CON制程，即属精密扰流喷流之槽液，与恢复两侧铜阳极的垂直自走挂镀；但由于成本及售价都极为昂贵，于是恢复铜阳极的自正式挂镀又开始受到重视。

BGA球脚之承焊铜垫内设微盲孔(Micro Vlain Pad)，不但可节省板面用地，而且一改旧有哑铃式(Dog Boning)层间通孔较长的间接互连(Interconnection)，而成为直上直

下较短的盲孔互连；既可减短线长与孔长而得以压制高频中的寄生噪讯外(Parasitics)，又能避免了内层Gnd/Vcc大铜面遭到通孔的刺破，而使得归途(Return Path)之回轨免于受损，对于高频讯号完整性(Signal Integrity)总体方面的效益将会更好。

然而此种做法在下游印刷锡膏与后续熔焊(Reflow)球脚时，众多垫内微盲孔中免不了会吸引若干锡膏的不当流入。此而负面效应；一则会因锡量流失而造成焊点(Solder Joint)强度的不足，二则可能会引发盲孔内锡膏助焊剂的气化而吹涨出讨厌的空洞(Voids),两者均使得焊点可靠度为之隐忧不已。